

Panasonic
ideas for life

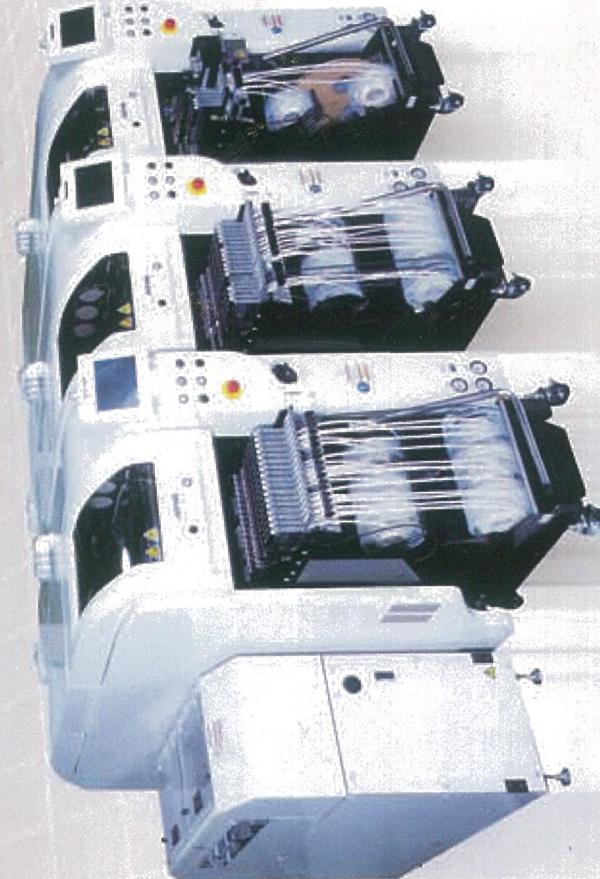
2011



电子元件实装系统
目录
多功能生产系统

NPM
NEXT PRODUCTION MODULAR

Manufacturing Process Innovation



机种名 NPM-D

型号:NM-EJM1D

型号:NM-EJM1D-MD

型号:NM-EJM1D-D

型号:NM-EJM1D-MA

型号:NM-EJM1D-A

这是LNB传送带+多功能生产系统3台连接时的外观照片。

*会随选购件的构成或客户规格，而不适用于机器指令和EMC指令。



NPM 对应实装变化的新构思设备

NEXT PRODUCTION MODULAR

1 在综合实装生产线实现高密度单位面积生产率

贴装 & 检查一连贯的系统，实现高效率和高品质生产

2 客户可以选择实装生产线

通过即插即用功能，能够自由设置各工作头的位置

3 通过系统软件实现生产线、生产车间、工厂的整体管理

通过生产线运转监控支撑计划生产



NEW CONCEPT MACHINE

综合生产线的解决方案

搭载检查头，实现省空间的安装生产线

通过在线检查实现高品质安装

⑯ … 16吸嘴贴装头

… 点胶头

SPI … 锡膏检查

AOI … 元件检查

⑫ … 12吸嘴贴装头

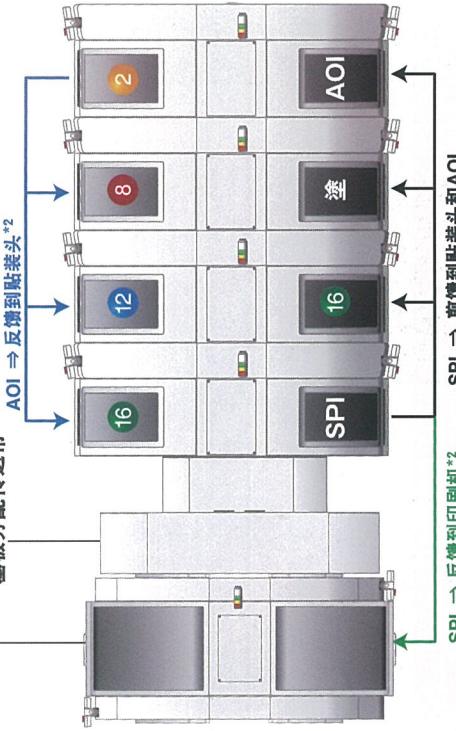
… 8吸嘴贴装头

⑧ … 2吸嘴贴装头

② … 2吸嘴贴装头

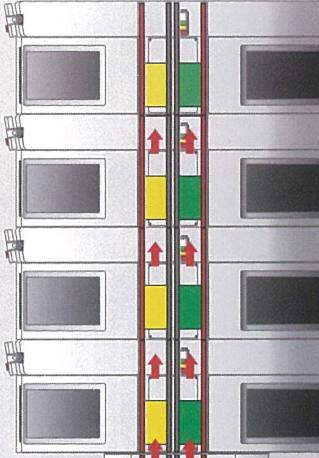
双轨锡膏印刷机

基板分配传送带^{*1}



多功能生产线

采用双轨传送带，能够在同一生产线上进行不同品种基板的混合生产。



NPM-D

基板分配传送带^{*1}

双轨锡膏印刷机



供给单元

点胶头

2D检查头

操作高度控制系统^{*2}

贴装操作向系统
APC系统对选购件
元件校对选购件
自动机种切换选购件
上位通信选购件

系统软件

NPM-DGS
数据编制系统

*1: 请客户准备基板分配传送带。

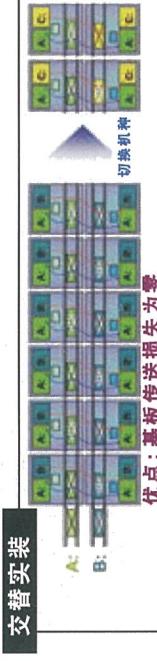
*2: 开发中

交替实装 · 独立实装

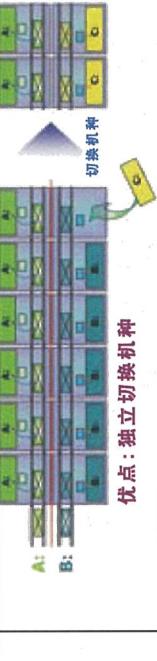
双轨实装方式有「交替实装」和「独立实装」，根据各自目的可以选择。

交替实装：设备前侧的贴装头在前轨基板，后侧贴装头在后轨基板进行实装。

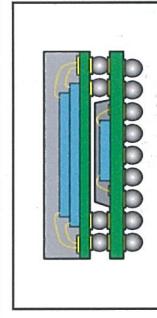
独立实装：设备前侧的贴装头在前轨基板，后侧贴装头在后轨基板进行实装。



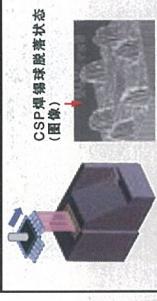
独立实装



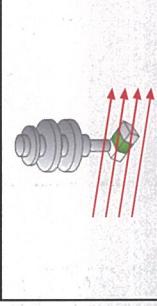
高性能 & 高信赖性



三维POP实装 (编带规格)



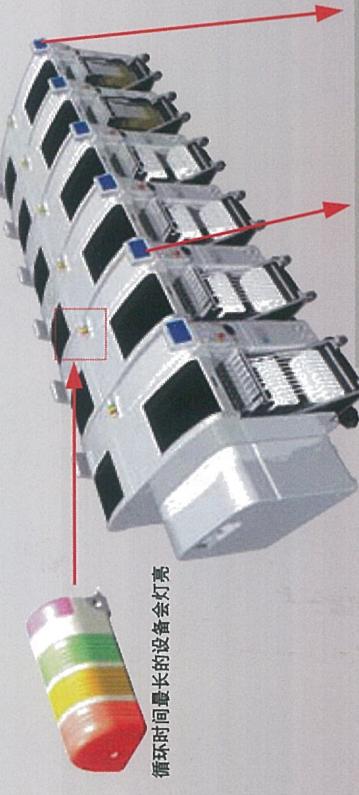
元件贴装 (Chip Placement)



垂直线性相机

操作导向

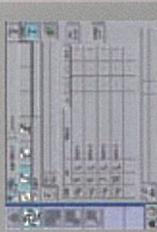
操作导向



循环时间最长的设备会灯亮



生产状况确认画面



操作指示画面

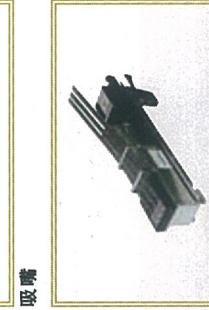
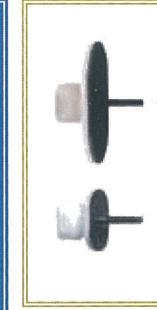
自动机种切换选购件

双轨正反面混合生产

芯片元件搭载率较高的正面和异形元件搭载率较高的反面，通过此正反面同时生产，可以解消瓶颈，而且由于正反面的交替生产可以减少半成品库存。

芯片元件 贴装速度是瓶颈	正面	16N	12N	2N
异形元件 贴装速度是瓶颈	反面	50秒	30秒	10秒
		10秒	30秒	50秒

● 由于在一侧轨道进行生产的同时，在另一侧轨道可以传送基板，基板传送时间为零。



杆状料架



机种切换指示

NPM-D	0.5分钟	→ 大约缩短2.5分钟
以前 (CM602)	操作次数: 4	操作次数: 3分钟
	操作次数: 16	1台所需的台车交换时间

锡膏检查(SPI)、元件检查(AOI) 检查头

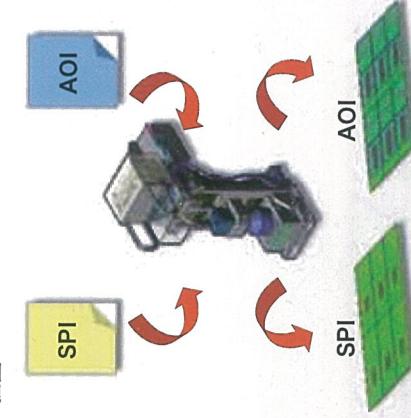
锡膏检查

· 锡膏的外观检查

	OK	NG
渗锡	OK	NG
少锡	OK	NG
偏位	OK	NG
形状异常	OK	NG
桥接	OK	NG

锡膏检查和元件检查的自动切换

· 根据生产数据，自动切换锡膏检查和元件检查



锡膏检查(SPI)、元件检查(AOI) 检查头

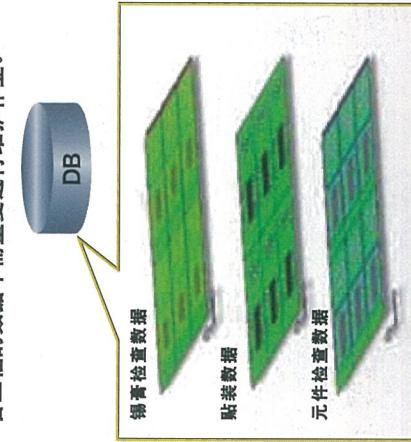
贴装后元件检查

· 贴装元件的外观检查

	OK	NG
元件有无	OK	NG
偏位	OK	NG
正反面桥接	OK	NG
极性不同	OK	NG

检查数据、贴装数据的一元化

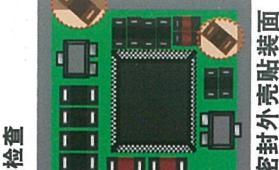
· 元件库以及坐标数据的一元化管理。
各工程的数据不需重复进行维护作业。



贴装前异物检查

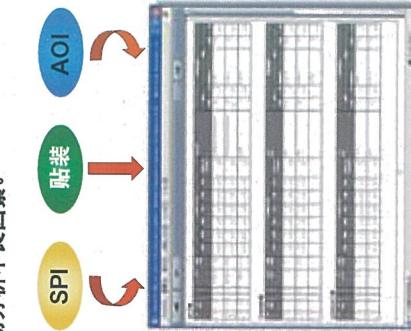
BGA贴装前的异物检查

· 密封外壳贴装前的异物检查



贴装前异物检查*

· 异物检查以芯片元件为对象。
帮助分析不良因素。



质量信息的自动链接

SPI

· 各工程的品质信息自动链接。



粘着剂点胶

AOI

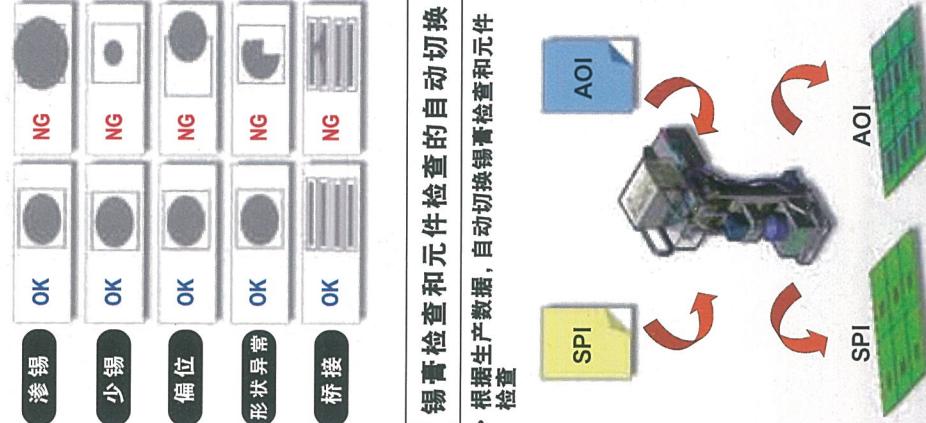
· 对各种打点和描绘点胶式样



螺旋式吐出装置

点胶头

· 使用高精度高度传感器(选购件)，测定基板局部范围的高度后进行点胶高度的补正，实现基板非接触点胶。



粘着剂点胶

螺旋式吐出装置

· 继承以往初种HDF中深受好评的吐出装置，
实现高品质点胶



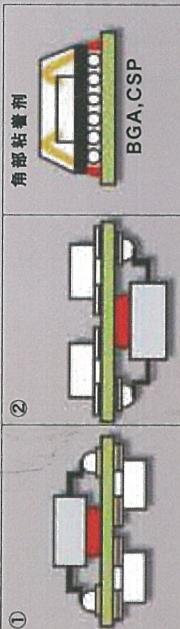
基板高度测定

基板

· 基板传送时，防止大型元件的偏移
①回流焊时，防止背面元件的脱落
③加强BGA、CSP的粘着性*



① 基板传送时，防止大型元件的偏移
② 回流焊时，防止背面元件的脱落
③ 加强BGA、CSP的粘着性*

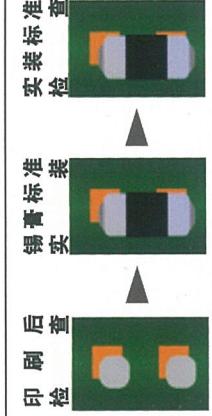


*需要事先验证。

高品质实装

前馈到贴装头

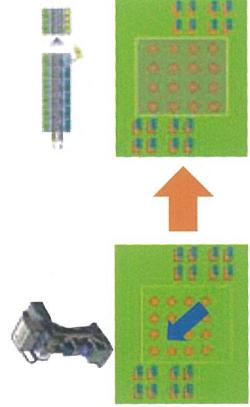
• 锡膏位置计测和前馈
对象：芯片元件（0402C/R~）
芯片包元件（QFP·BGA·CSP）



APC系统

转印元件的高精度安装

• APC补正位置和前馈到转印元件



• APC补正位置上的位置检查



防止元件交换时的安装错误。
操作简单，为提高生产效率做贡献的系统。



元件校对选购件

自动机种切换选购件

- 防止元件错误安装
将下载到NPM-D的生产数据与进行交换的元件的条形码信息进行校对，
可防止元件的错误安装。
- 排列数据同步功能
NPM-D主体进行校对，不需要另外选择排列数据。
- 联锁功能
联锁校对、未校对时，使设备停止。
- 导向功能
通过设备画面和智能料架的联动，使校对作业简单明了。
- 扫描器选择
可以选择有线扫描器或无线扫描器（PDA）。



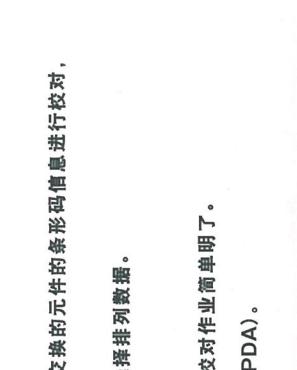
高生产率

支援机种切换作业（生产数据、轨道宽度等），
并将其作业损耗控制到最小限度。

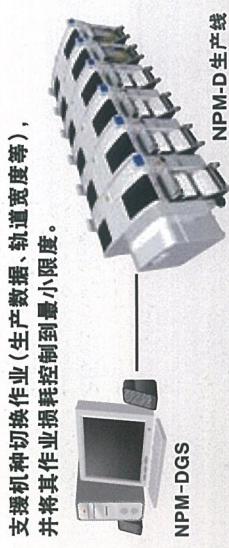


支援站

支援站



公开界面



上位通信选购件

准备交换台车和料架的离线准备，
不仅在生产区域，也可以在准备区进行，不受场所限制。

● 可以选择电源供给类型。

- ① 电源供给类型：
交换台车准备功能…对搭载台车的所有料架进行电源供给
料架准备功能…每1台料架为单位进行电源供给
- ② 元件校对类型：
在电源供给类型追加元件校对功能。
具有导向功能，会显示哪里需要切换料架。

公开界面

备有标准界面，能够进行必要信息的相互通信。



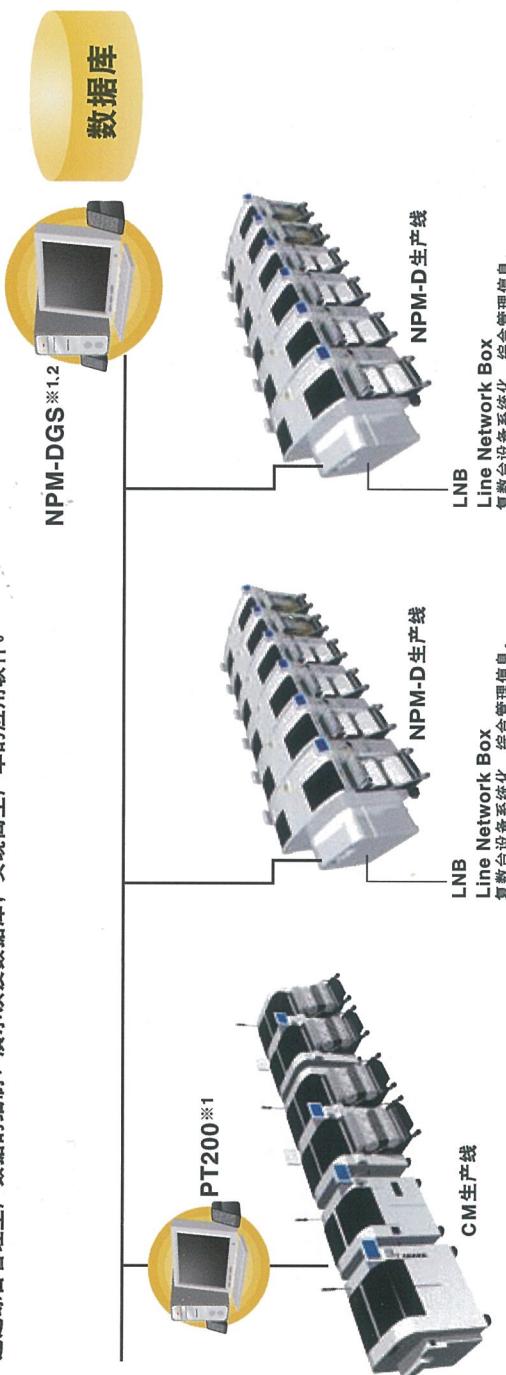
上位通信选购件

- 履历状况
实时输出设备的履历状况。
- 其他公司元件校对
与客户的元件校对系统进行相互通信。
- 元件管理信息
元件剩余数量信息…输出元件信息(*1)和基板信息(*2)相结合的信息。
- 跟踪信息…输出元件信息(*1)和基板信息(*2)相结合的信息。
- (*1)需要使用元件校对选购件或者此选购件的其他公司元件校对系统I/F进行元件信息的输入。
- (*2)需要使用自动机种切换选购件进行基板信息的输入。

数据编制系统

NPM-DGS (型号: NM-EJS9A)

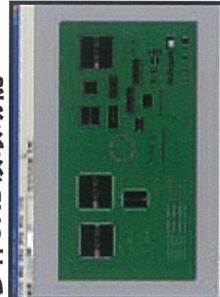
通过综合管理生产数据的编辑、演示以及数据库，实现高生产率的应用软件。



*1:需要另外购买电脑。

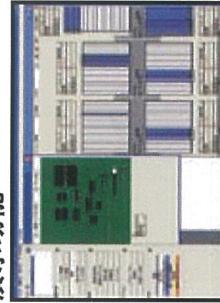
*2:NPM-DGS有车间水平和生产线水平的管理功能。

多种CAD读取功能



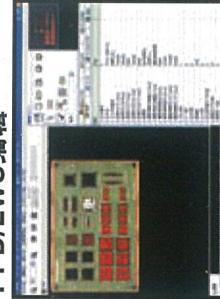
通过宏定义登录，几乎可以获取所有的CAD数据。而且可以在画面上确认可行性等情况。

演示功能



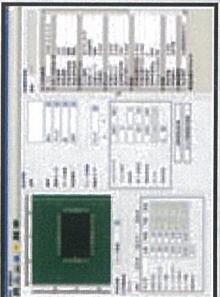
在画面上可以事先确认摸拟速度等数据，提高了生产线的综合运转率。

PPD/LWS编辑



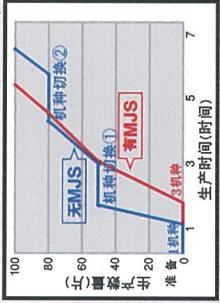
通过将贴装头和检查头的数据放在生产中的电脑画面上进行迅速、简单的编辑，减少了时间损失。

元件库功能



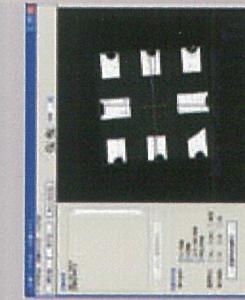
可以登录整个车间的安装设备的元件库，实现包括CM系列设备在内的数据综合管理。

Mix Job Setter (MJS)

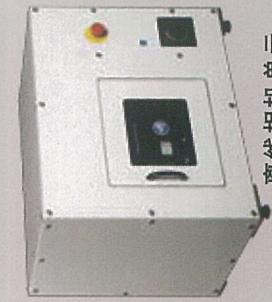


通过复数生产机种数据组合最佳化，进行料架的共同化配置。通过减少机种切换时的料架交换时间，提高了生产率。

离线相机单元(选购件)*开发中



识别试验、评估画面



离线相机单元

机 种	名 称	NPM-D
前侧工作头	后侧工作头	16吸嘴贴装头
16吸嘴贴装头		12吸嘴贴装头
12吸嘴贴装头		8吸嘴贴装头
8吸嘴贴装头		NM-EJ MID
2吸嘴贴装头		NM-EJ MID-MD
点 跟 头		NM-EJ MID-MA
检 查 头		NM-EJ MID-A
无工作头		NM-EJ MID-D
基 板 尺 寸	双 轨 式	L 50 mm × W 50 mm ~ L 510 mm × W 300 mm
	单 轨 式	L 50 mm × W 50 mm ~ L 510 mm × W 590 mm
电 源	三相 AC 200, 220, 380, 400, 420, 480 V	2.5 kVA
设 备 尺 寸 ²	0.5 MPa, 100 L/min (A.N.R.)	
重 量	W 835 mm × D 2 652 mm ³ × H 1 444 mm ⁴	
	1 520 kg (只限主体: 因选购件的构成而异)	

贴 装 头	16 吸嘴贴装头 (搭载2个贴装头时)	12 吸嘴贴装头 (搭载2个贴装头时)	8 吸嘴贴装头 (搭载2个贴装头时)	2 吸嘴贴装头 (搭载2个贴装头时)	2 吸嘴贴装头 (搭载2个贴装头时)
贴装速度 最快速度	70 000 cph(0.051 s/芯片)	62 500 cph(0.058 s/芯片)	40 000 cph(0.090 s/芯片)	8 500 cph(0.423 s/QFP)	
IPC9850(1608)	53 800 ⁵	48 000 ⁵			
贴装精度 (Cpk≥1)	± 40 μm/芯片	± 40 μm/芯片	± 40 μm/芯片	± 30 μm/QFP	± 30 μm/QFP
元 件 尺 寸	0402芯片 ⁶ ~L 6 mm × W 6 mm × T 3 mm	0402芯片 ⁶ ~L 12 mm × W 12 mm × T 6.5 mm	0402芯片 ⁶ ~L 32 mm × W 32 mm × T 12 mm	0603芯片 ⁶ ~L 100 mm × W 90 mm × T 28 mm	
元 件 编 带	编带宽: 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 44 / 56 mm	编带宽: 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 44 / 56 mm	编带宽: 8 / 56 / 72 / 88 / 104 mm		
元 件 供 给	8 mm 编带 : Max, 68 连(双式编带料架时, 小卷盘)			状态: Max, 8 连, 托盘: Max, 20 个 (1台托盘供料器)	
点 胶 头	打 点 胶	描 绘 点 胶			
点 胶 速 度	0.16 s/dot (条件: XY=10 mm, Z=4 mm 以内移动、无θ旋转)	3.75 s/元件 (条件: 30 mm × 30 mm 角部点胶)			
点胶位置精度 (Cpk≥1)	± 75 μm/dot	± 100 μm/元件			
对 象 元 件	1608芯片~SOP、PLCC、QFP、连接器、BGA、CSP	SOP、PLCC、QFP、连接器、BGA、CSP			

检 查 头	2D检查头 (A)	2D检查头 (B)		
分 野	18 μm	9 μm		
视 检	44.4 mm × 37.2 mm	21.1 mm × 17.6 mm		
检 查 项 目	元件检查 ⁸	元件检查 ⁸	元件检查 ⁸	元件检查 ⁸
检 对	锡膏检查 ⁸	锡膏检查 ⁸	锡膏检查 ⁸	锡膏检查 ⁸
检 查 精 度	0.5 s/视 野	0.35 s/视 野	0.5 s/视 野	0.5 s/视 野
检 查 项 目	元件检查 ⁸	元件检查 ⁸	元件检查 ⁸	元件检查 ⁸
检 查 位 置 精 度	0.4 mm	0.3 mm	0.4 mm	0.3 mm
检 查 点 数	Max, 30 000 点/设备	Max, 10 000 点/设备	Max, 10 000 点/设备	Max, 10 000 点/设备

*贴装速度、检查时间及精度等值, 会因条件而异。
*详细请参照《规格说明书》。

*1: 由于基板传送基准不同, 与NPM (NM-EJ/M9B) 双轨规格不可连接。
*2: 只限主体。
*3: 托盘供料器贴装时D尺寸 2 683 mm、交换台车安装时D尺寸 2 728 mm
*4: 不包括识别监控器、信号塔
*5: 这是以PC9850为基准的参考速度。
*6: 0402芯片, 需要专用吸嘴和料架

安全注意事项

● 使用前, 请务必仔细阅读使用说明书, 再正确使用。
 ● 为了安全使用目录中所记载的商品, 在使用时, 无论是在商品的运转时, 还是停止时, 都请仔细确认设备附属的使用说明书及设备的警告告示之后, 再进行正确的操作。

ISO 14001 系统, 取得国际规格ISO14001:2004认证。

咨询...
松下生产科技株式会社
菅业总括部

脚编 409-3895 日本国山梨县中巨摩郡昭和町纸漉阿原 1375番地
电话 +81-055-275-9148
传真 +81-055-275-6269

本目录的记载内容为2010年12月1日
时的内容。
Ver.2010.12.1